

Az egységes BME egyetemi TDK portál használata

1. rész

Készítette: Dr. Iváncsy Renáta

2012.09.20.

Jelen dokumentum röviden összefoglalja, hogy milyen lépéseken keresztül tud egy hallgató dolgozatot regisztrálni egy, a portálon meghirdetett konferenciára.

Tartalom

1	Regisztráció a portálra.....	2
2	Konferencia választás	2
3	Dolgozat regisztráció	2
3.1	Alap adatok megadása	2
3.2	Szerzők megadása	3
3.3	Konzulensek megadása	4
3.4	Magyar és angol összefoglaló megadása	5
3.5	Véglegesítés.....	6
4	A dolgozatok listájának megtekintése, dolgozat adatainak módosítása, dolgozat beadás	6

1 Regisztráció a portálra

Az első lépés a portálra való regisztráció. Ehhez a <http://tdk.bme.hu> oldalon a jobb felső sarokban található „Bejelentkezés és regisztráció” linkre kell kattintani, majd a megjelenő ablakban kiválasztani a regisztráció opciót. Itt kell megadni a használni kívánt email címet, egyedi felhasználói nevet (ha a név nem egyedi, erről a rendszer értesíti a felhasználót), valamint meg kell adni a jelszót megerősítve.

A regisztrálás után a felhasználó bejelentkezett állapotba kerül, később a regisztráció során megadott adatokkal tud ismét belépni.

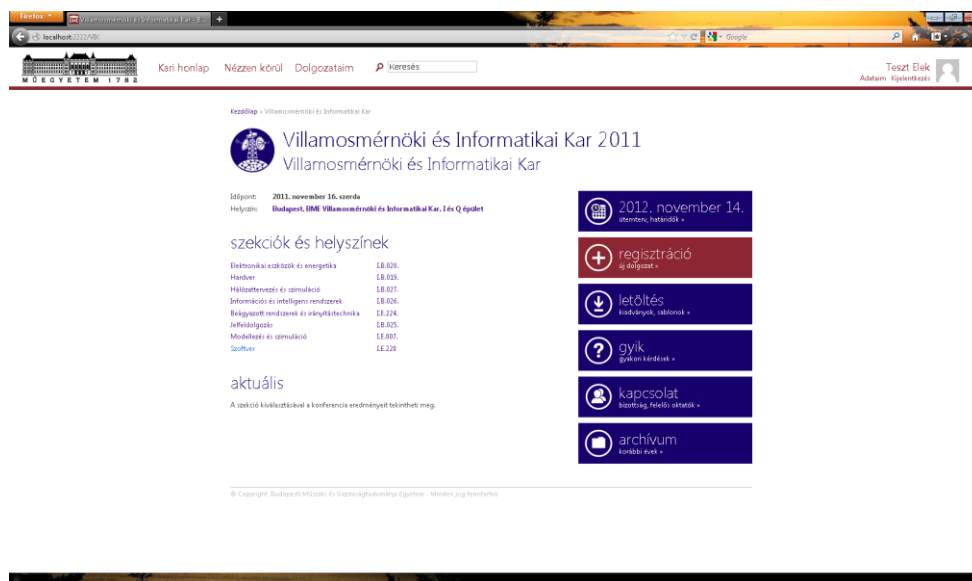
2 Konferencia választás

Az egész portál felépítése a karok köré épül. Egy felhasználó legelőször egy kart választ, és csak utána tud az adott karhoz tartozó aktuális konferenciával kapcsolatosan további műveleteket végrehajtani.

Kart választani a kezdő lapon a jobb felső sarkban felsorolt kari logók egyikének kiválasztásával lehet.

3 Dolgozat regisztráció

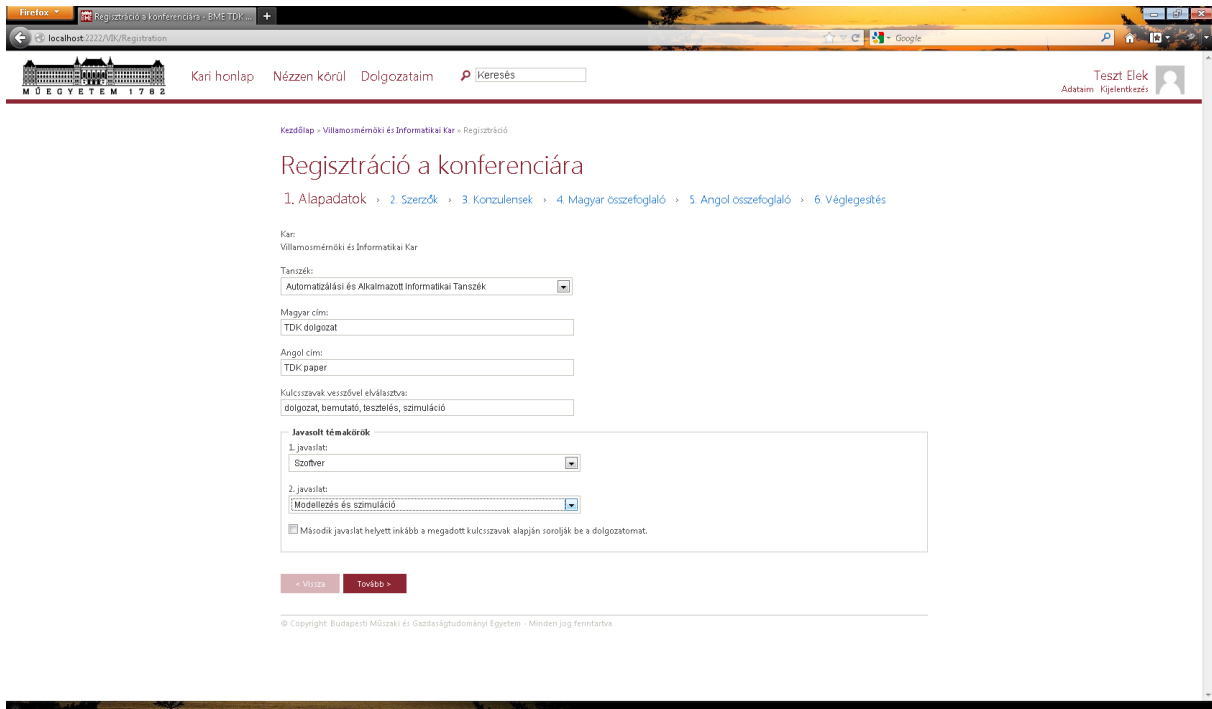
Amennyiben az adott karon a dolgozatok regisztrációja engedélyezett, a kari honlapon megjelenik egy színnel is megkülönböztetett menüpont a képernyő jobb oldalán „regisztráció” felirattal.



3.1 Alap adatok megadása

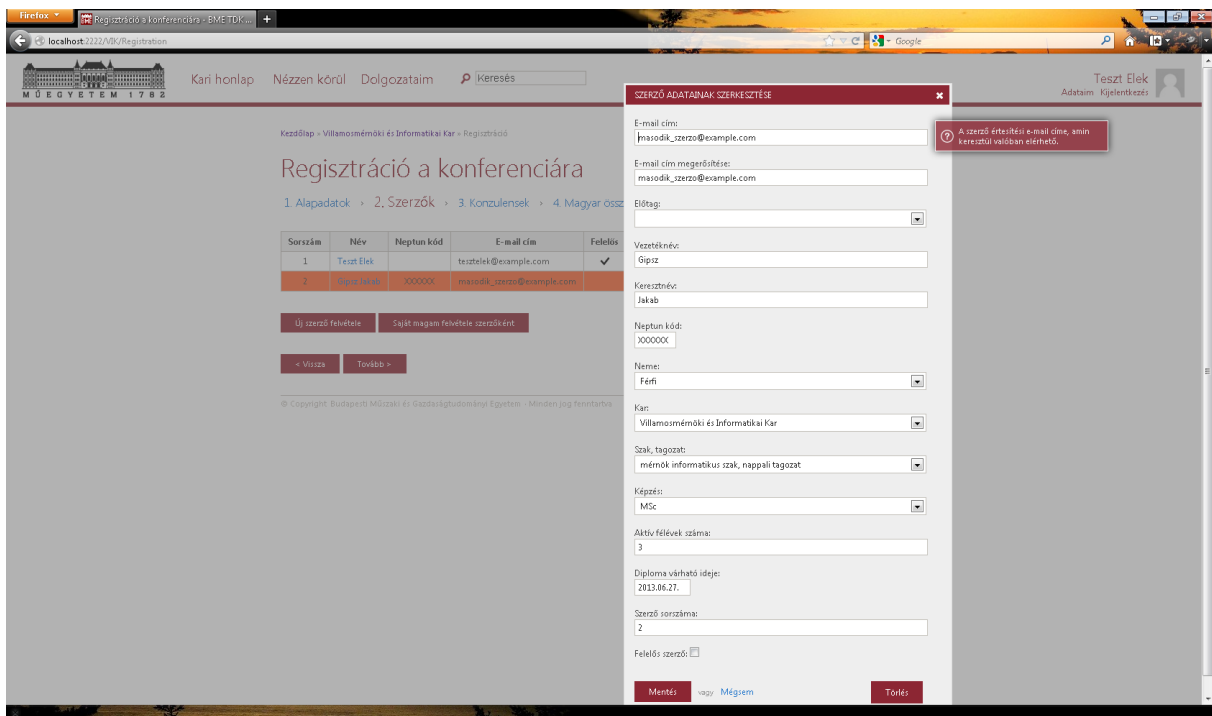
A regisztráció gomb megnyomása után a dolgozat regisztrációs folyamat első lépésére kerülünk.

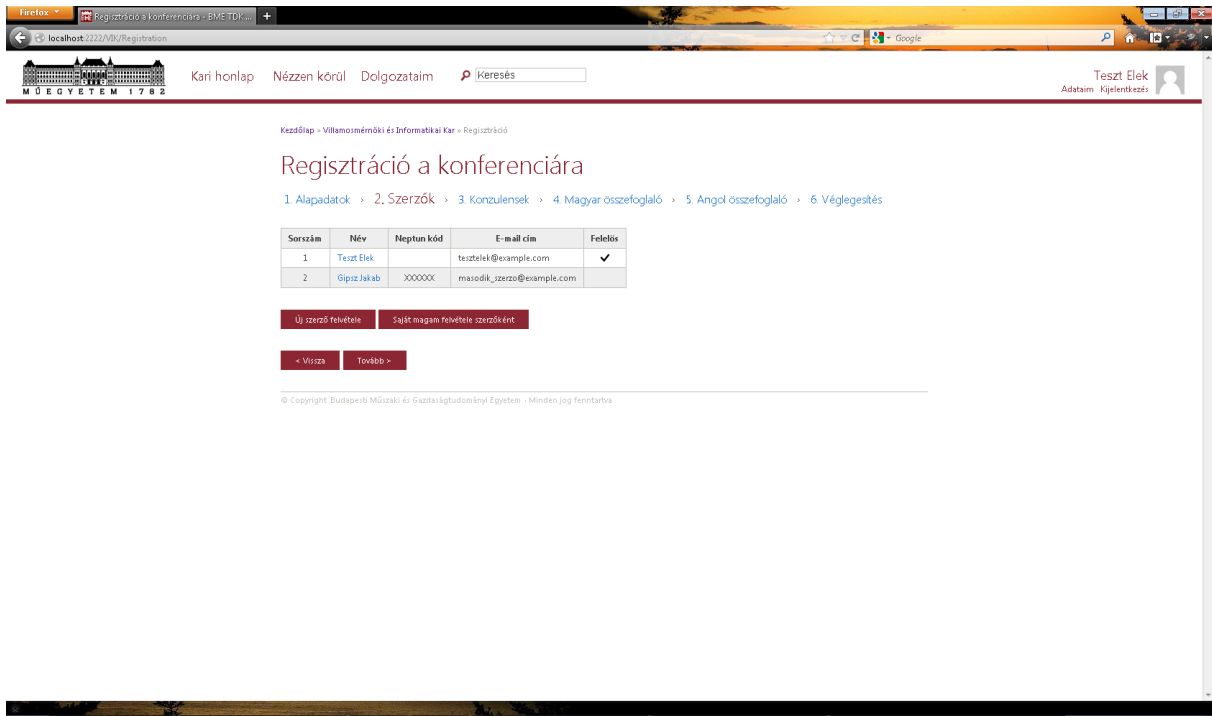
Itt lehet megadni a dolgozatokkal kapcsolatos alapadatokat, mint a beadás tanszéke (a kar már rögzített, hiszen már a legelején kart választottunk), a dolgozat magyar és angol címe, a kötelezően kitöltendő kulcsszavak listája, valamint itt lehet választani témakört is. A második témakör helyett ki lehet választani, hogy a bizottság inkább a kulcsszavak alapján sorolja szekcióba a dolgozatot, mert nem tud kellően illeszkedő második témakört megjelölni. Egy témakört viszont mindenképp kötelező megadni. A tovább gomb megnyomásával lehet tovább lépni a következő lépésre.



3.2 Szerzők megadása

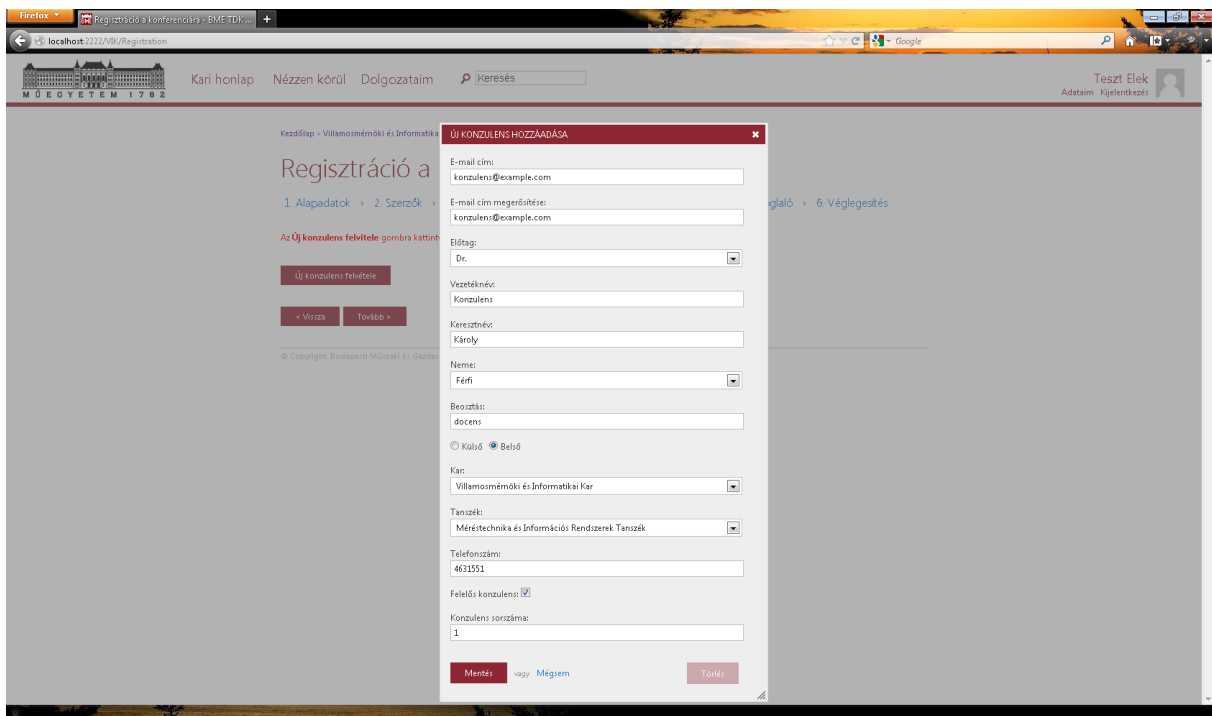
A második lépés a dolgozat szerzőinek a megadása. Itt lehetőség van a „saját magam felvétele szerzőként” opciót kiválasztva magunkat felvenni a rendszerbe. Az „új szerző felvétele” gomb megnyomásával lehet felvinni a dolgozat további szerzőit.





3.3 Konzulensek megadása

A konzulensek megadása teljesen hasonló a szerzők megadásához.



A konzulensnél ki lehet választani, hogy belső, vagy külső konzulens, ennek fényében más-más adatokat kér be a rendszer.

Firefox - Regisztráció a konferenciára - BMEITDK...
 localhost:2222/0/Registration

Kari honlap Nézzén körül Dolgozataim Keresés

Műegyetem 1782 Teszt Elek Adatam Kijelentkezés

Kedzőlap - Villamosmérnöki és Informatikai Kar - Regisztráció

Regisztráció a konferenciára

1. Alapadatok > 2. Szerzők > 3. Konzulensek > 4. Magyar összefoglaló > 5. Angol összefoglaló > 6. Véglegesítés

Sorszám	Név	E-mail cím	Besorolás	Intézmény	Külső	Felelős
1	Konzulens Károly Dr.	konzulens@example.com	docens	Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék		<input checked="" type="checkbox"/>

[Új konzulens felvétele](#)

[Vissza](#) [Tovább >](#)

© Copyright Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem - Minden jog fenntartva

3.4 Magyar és angol összefoglaló megadása

A magyar és az angol összefoglaló megadása esetén be kell másolni az összefoglaló szövegét a szövegdobozba. Ha a konferencián engedélyezett a kép feltöltése, azt a szövegdoboz alatti feltöltés gombra kattintva lehet megtenni.

Firefox - Regisztráció a konferenciára - BMEITDK...
 localhost:2222/0/Registration

Kari honlap Nézzén körül Dolgozataim Keresés

Műegyetem 1782 Teszt Elek Adatam Kijelentkezés

Kedzőlap - Villamosmérnöki és Informatikai Kar - Regisztráció


Regisztráció a konferenciára

1. Alapadatok > 2. Szerzők > 3. Konzulensek > 4. Magyar összefoglaló > 5. Angol összefoglaló > 6. Véglegesítés

Magyar nyelvű összefoglaló:

Az elmúlt évtizedekben a félvezető gyártás vált az infokommunikációs technológia fejlődésének hajtóerejévé. A félvezető eszközök csökkenő méretei újabb kihívásokat támasztanak az elektronikai ipar többi részvevője felé. A miniatürizálás üteme nem csökken, a félvezető eszközök és az áramkört hordozó, vagy a tokozás kontaktusfelületeinek elektronikus összeköttetése egyre inkább csak mikrochipszártszerű, vagy még ennél is fejlettebb réteglegyszerűsítéssel, 3D-s integráció esetén furafémzésessel (pl. TSV through silicon via technológiával) valósítható meg. Ezzel egyidejűleg a felhasználók által megkívánt szigorú minőségi elvárások és a gyártói oldal költségkímélését szem előtt tartó magatartása újabb és újabb mérnöki megoldásokat hív életre. Ez teszi aktuálissá a tömeggyártásba is már bevezetett innovatív módszerekkel és gyártószerzőkkel készített termozónikus arany mikrochipszártszerű technológiájának elemzését, valamint szerkezetének és minőségének vizsgálatát. A 25 um-es átmérőjű arany mikrochipszártszerű elemek vizsgálatainak egyik módszere a termociklus teszt, mely során a huzal nem elhanyagolható mechanikai igénybevételnek van kitéve. A teszt során bekövetkező anyagszervezet változások a kötés gyengüléséhez, későbbi könnyebb szakadásához vezethetnek. Munkám során a huzalok kötés tulajdonságainak, szerkezetének, anyagszervezetének megismerésére, valamint a leggyakrabban előforduló hibák okainak feltárására helyeztem hangsúlyt, célul tűzve a hibák kiküszöbölését.

[1] George O. Haman, Wire Bonding in Microelectronics, McGraw-Hill Prof MedTech, 0071476237, 2010
 [2] Shankara K. Prasad, Advanced Wirebond Interconnection Technology, Springer Netherlands, 1402077829, 2004



[Mégis letöltése](#)

3.5 Véglegesítés

A regisztráció utolsó lépéseként megnézhetjük a fontosabb adatokat, amit regisztráció során megadtunk.

Regisztráció a konferenciára

1. Alapadatok > 2. Szerzők > 3. Konzulensek > 4. Magyar összefoglaló > 5. Angol összefoglaló > 6. Véglegesítés

TDK dolgozat

Az elmúlt évtizedekben a félvezető gyártás vált az infokommunikációs technológia fejlődésének hajtóerejévé. A félvezető eszközök csökkenő méretű újabb funkciókat támasztanak az elektronikai ipar többi részvevője felé. A miniatürizálás útjére nem csökkén, a félvezető eszközök és az áramlóni hordozó, vagy a tokozás: kontaktusfelületeinek elektromos összeköttetési egyre inkább csak mikrohuzal-kötésekkel, vagy még ennél is fejlettebb rétegtechnológiákkal, 3D-s integráció esetén furatfémzésessel (pl. TSV through silicon via technológiával) változhatnak meg. Ezzel egyidejűleg a felhasználók által megkívánt szigorú miniségi elvárások és a gyártási oldali költségvetési korlátokat szem előtt tartó megvárakozás újabb és újabb memóriai megoldásokat hív életre. Ez teszi aktuálissá a hőmérsékletre is már bevezetett innovatív módszerekkel és gyártóeszközökkel készített termozónikus arany mikrohuzal-kötések technológiájának elemzését, valamint szerkezetének és minőségének vizsgálatát. A 25 um-es átmérőjű arany mikrohuzal-kötések élettartam vizsgálatának egyik módszere a termocillus teszt, mely során a huzal nem elhanyagolható mechanikai igénybevételnek van kitéve. A teszt során bekövetkező anyagtervezési változások a kötés gyengülését, későbbi környezeti szakadásiához vezethetnek. Munkám során a huzaloktatók tulajdonságainak, szerkezetének, anyagtervezésének megismerésére, valamint a leggyakrabban előforduló hibák okainak feltárására helyeztem hangsúlyt, célul kitűzve a hibák kiküszöbölését.

[1] L. George G. Haman, Wire Bonding in Microelectronics, McGraw-Hill Prof Med/Tech, 0071476237, 2010


[2] L. Shankara K. Prasad, Advanced Wirebond Interconnection Technology, Springer Netherlands, 1402077629, 2004

Szerzők

- Test Etek**
MSc képzési
egészségügyi memóriai szak
- Gipsz Jakab**
MSc képzési
memóriai informatikus szak

Konzulens

- Konzulens Károly Dr.**
docens
Méréstechnika és Információs Rendszerek
Tanszék



Hallgatói nyilatkozat

Kijelentem, hogy ezt a TDK dolgozatot meg nem engedett regisztrációm nélkül, saját magam készítettem, csak a megadott forrásokat (szakirodalom, eszközök stb.) használtam fel. Minden olyan részt, melyet szó szerint, vagy azonos értelemben, de átfogalmazva más forrásból átvettem, egyértelműen, a forrás megadásával jeleztem.

Itt el kell fogadni a hallgatói nyilatkozatot, majd a tovább gomb megnyomásával véglegesítjük a beadást.

4 A dolgozatok listájának megtekintése, dolgozat adatainak módosítása, dolgozat beadás

A belépett felhasználó fejlécben megtalálja a dolgozataim menüpontot. Itt lehet megtalálni az általunk beadott, konzultált vagy esetleg bírált dolgozatok listáját.

A dolgozat mellett szereplő ceruza ikonra kattintva visszajutunk a regisztrációs lépésekhez, természetesen azokat az adatokat megjelenítve, amiket már korábban bevittünk. Itt van lehetőség az adatok módosítására.

A dolgozat feltöltését a dolgozat sorában megjelenő fájlkiválasztó és feltöltő modul használatával kell megtenni. A feltöltéshez ki kell választani, hogy a dolgozat publikus (a konferencia után az interneten elérhető), vagy titkos.

Firefox - Dolgozataim - BME TDK Portal

localhost:2222/MS/M/Papers

Kari honlap Nézzén körül Dolgozataim keresés

Teszt Elek
Adataim Kijelentkezés

Kezdőlap - Kar - Dolgozatok

Dolgozataim

Bírálóknak

- TDK 2011
Nincs bírálóidő dolgozat.
- TDK 2010

Konzulenseknek

- TDK 2011
Nincs konzultált dolgozat.
- TDK 2010

Beadott dolgozatok

- TDK 2011

Dolgozat adatai	Publikusság	Fájl	Feltöltés
TDK dolgozat Szerzők: Teszt Elek, Sipicz Jakab Konzulens: Konzulens Károly Dr. (MIT)	Válasszon egyet	<input type="text"/> Browse...	Feltöltés

- TDK 2010

© Copyright Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem - Minden jog fenntartva